

2015 年 11 月 18 日

各位

株式会社バイテックホールディングス
バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社

韓国 CrucialMachines 社との資本業務提携

レーザーリフロー&TC ボンディング/プローブカード用レーザーボンディング装置 販売開始

株式会社バイテックホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：今野 邦廣）は、韓国装置メーカーCrucialMachines 社と資本業務提携を締結いたしました。今後、国内外におけるレーザーリフロー&TC ボンディング装置、プローブカード用レーザーボンディング装置の販売に取り組みます。

レーザーリフロー&TC ボンディング装置は、通常のリフロー炉の代わりにレーザー光を瞬間的に照射する設備で半田を溶解し実装いたします。レーザー光を用いることで局所的な加熱が可能となるため、リフロー時の課題であった基板への熱ダメージ、基板の反り等の改善が見込まれ、生産性（歩留り）が向上いたします。さらに CrucialMachines 社の独自技術(TOP-hat Beam 方式)により基板に対し面でのレーザー光照射が可能となるため、通常レーザー半田付け装置と比較し実装時間を大幅に短縮することが可能となりました。

プローブカード用ボンディング装置は、ワールドワイドで年間 12 億ドル規模の市場と言われており、当社は日本、米国での販売に注力してまいります。CrucialMachines 社のレーザーボンディング装置は、従来の MEMS 型ピンプローブカードの約半分の価格と 1/4 のリードタイムが実現できる見込みです。

当社グループは、CrucialMachine 社のレーザーリフロー&TC ボンディング装置、プローブカード用レーザーボンディング装置の販売推進を図るとともに、韓国モジュールメーカーCrucialTec 社とも戦略的な関係構築の強化にも取り組んで参ります。



左より：当社執行役員 金 永暉、当社代表取締役会長兼社長 今野 邦廣、CrutialMachins Ahn 代表、CrutialMachins Choi SVP

本件に関する問い合わせ先

バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社 営業推進本部

TEL 03 - 3458 - 0301

Crutialtec URL <http://www.crucialtec.com/eng/>

バイテックホールディングス <http://www.vitec.co.jp/>